



技术参数表

Qsil553 灌封硅胶材料

产品描述

Qsil553 是 100%硅胶固体弹性体，为电子灌封应用设计。该型号是双组份体系，具有阻燃、导热、低模量的特点，具有可修复性。

主要特点

- 100%固体—无溶剂
- 操作时间长
- 低模量
- 好的伸长率
- UL 认证

典型特点

固化前		
	Qsil 553A	Qsil 553B
外观	米白色	黑色
粘度	5000cps	3500cps
比重	1.60	1.60

固化特点	
混合比率 1:1	
操作时间	100 分钟

*操作时间是指胶料粘度达到 25000cps 所需要的时间。

固化后特点	
7 分钟@150°C	
硬度, Shore A	40
拉伸强度	250psi
伸长率	240%
撕裂强度	45ppi
100%模量	180psi

电气性能	
耗散因素	0.009
介电常数@1000Hz	3.08
体积电阻率	4.02×10^{14} ohm-cm
相对漏电起痕指数 (CTI)	600volts
性能等级分类 (PLC)	0
UL 等级 (UL 号: E205830)	

UL 94 V-0	3.0mm
UL 94 V-1	1.5mm
导热特性	
导热系数	~0.68W/mk
耐温范围	-55-240℃

混合

为达到最佳性能，请使用同一批次的 Qsil553 A 和 Qsil553 B。
Qsil553 A 和 Qsil553 B 在固化之前应彻底混合搅拌均匀。

手工混合

按重量比 1:1 将 Qsil553A 和 Qsil553B 放入一个干净的塑料或金属容器内进行混合搅拌，容器容量需是混合胶量的 3 倍左右。当手工混胶时，胶量在合适范围内的准确称量对产品性能是至关重要的。

自动点胶

使用自动灌封系统进行灌胶时，按重量比 1:1 混合 Qsil553 A 和 Qsil553B。

抽真空

混合过程中滞留的空气需在 29 寸大气压下进行抽真空排气。在抽真空过程中，胶料会膨胀，所以需要间歇性抽真空。

机器混胶一般不需要进行抽真空。

存储和有效期

Qsil553A 和 Qsil553B 存储在不高于 25℃ 的环境下，有效期为 1 年。

免责声明

上述所提供技术参数仅供参考，不能作为产品标准规格。